



平成 18 年 6 月 27 日

各 位

会社名 エルピーダメモリ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 坂本幸雄
(コード番号：6665 東証第1部)
問合せ先 取締役兼 COO 大塚周一
(TEL. 03 - 3281 - 1500(代))

広島エルピーダにおける設備投資方針決定について

当社は、平成 18 年 6 月 27 日開催の当社取締役会において、広島エルピーダにて稼働中の 300 ミリウェハ対応工場(以下、E300 ファブ)の増強を目的とした設備投資を、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

広島エルピーダの今期、および来期以降の E300 ファブの半導体製造装置購入を含む設備投資の目的、内容については、次の通りです。

1. 設備投資の目的

- ・ 旺盛なモバイル機器向け DRAM の需要への対応
- ・ 先端プロセスである 70nm プロセス以下に対応した生産能力

2. 設備投資の内容

E300 ファブは、平成 13 年 2 月に建設に着工し、平成 15 年 1 月に量産を開始したエリア 1 と、平成 16 年 6 月に着工し、平成 17 年 10 月に稼働を開始したエリア 2、およびエリア 2 と同時に着工し、未稼働のエリア 3 からなります。エリア 2 は、総面積の約半分に生産設備装置が設置されており、エリア 1 およびエリア 2 を合わせた現在の月産ウェハ処理能力は約 5 万 5 千枚です。

4 月 25 日発表の決算短信に記載の通り、今年度の設備投資につきましては、月産ウェハ処理能力を 6 万枚までに増強する計画を既に発表しております。6 万枚以降、10 万枚までの能力増強は、概ね、以下の 3 段階に分けて検討をいたします。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧ください。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国証券法(以下「米国証券法」)に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、または登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出人から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募が行われる予定はありません。

月産ウェハ処理能力	概算設備投資額	完了時期
6万7千枚まで	530億円	平成18年度中
8万5千枚まで（エリア3のクリーンルーム建設含む）	1,450億円	平成19年度中
10万枚まで	1,080億円	平成20年度中
計	3,060億円	

注：10万枚までの完了時期は、市況に応じて平成19年度までに繰り上げる可能性もあります。

以 上

報道関係からのお問い合わせ先

エルピーダメモリ株式会社

広報グループ 小林

電話：03-3281-1648

E-mail：press@elpida.com

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、または登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出人から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募が行われる予定はありません。